

(43) 国際公開日
2007 年 4 月 26 日 (26.04.2007)

PCT

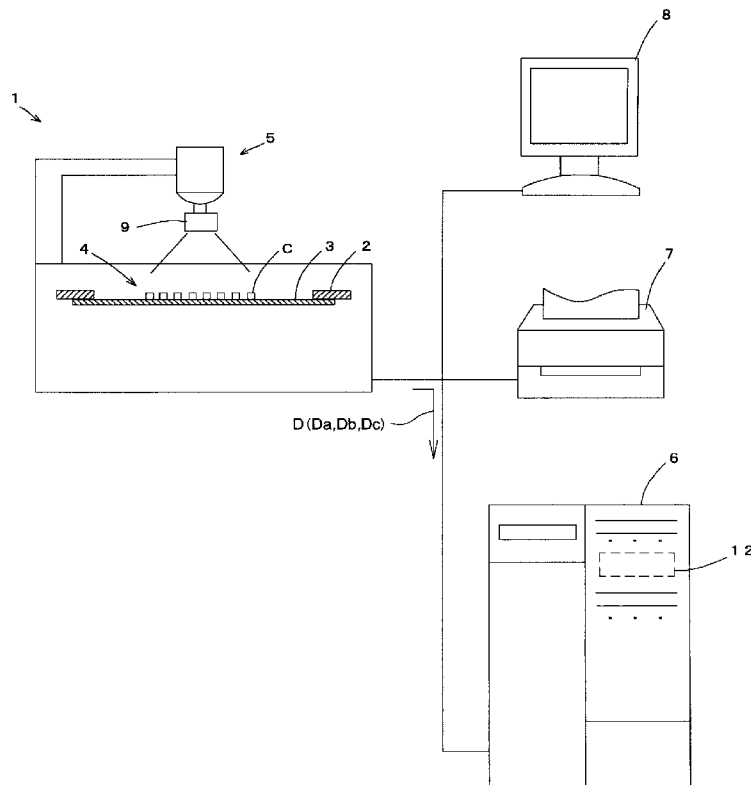
(10) 国際公開番号
WO 2007/046234 A1

- (51) 国際特許分類:
G01B 11/14 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/319837
- (22) 国際出願日: 2006 年 10 月 4 日 (04.10.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2005-301772
2005 年 10 月 17 日 (17.10.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 當摩 明紀 (TOMA, Akinori) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 黒川 秀二 (KUROKAWA, Shuji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 杉下 芳昭 (SUGISHITA, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 和田 成則, 外 (WADA, Shigenori et al.); 〒1010047 東京都千代田区内神田 1 - 1 5 - 1 6 東光ビル 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG,

[続葉有]

(54) Title: MEASURING DEVICE

(54) 発明の名称: 測定装置



(57) Abstract: [PROBLEMS]

To provide a measuring device preferable to improve the capability of picking up each chip cut from a plate member. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] A semiconductor wafer (4), an object to be measured, is supported by a support (H) composed of a ring frame (2) having an opening to which an adhesive sheet (3) is adhered. The semiconductor wafer is produced by cutting into chip-like plate member. An image processing unit (5) measures the chip intervals G and a shift angle θ . The measurement data D is sent from the image processing unit (5) to a host computer (6) and stored in storage means (12) of the host computer (6). According to the chip intervals G and the shift angle θ store in the storage means (12), a position recognition when the position of a chip is confirmed with a recognition unit of a pick-up device, for example, a camera, and correction of aligning the position of a collect for pick-up with the recognized position can be carried out at the next step.

[続葉有]

WO 2007/046234 A1



PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 【課題】チップ状に個片化された板状部材の各チップをピックアップする際のピックアップ処理能力を向上させるのに好適な測定装置を提供する。【解決手段】リングフレーム2の開口部に接着シート3が貼付された支持体Hに支持され、切断によってチップ状に個片化された板状部材としての半導体ウエハ4を測定対象物とし、画像処理ユニット5が当該チップ間隔Gとずれ角 θ とを測定し、その測定データDが画像処理ユニット5から上位コンピュータ6へ送出され、該上位コンピュータ6の記憶手段12に記憶されるように構成し、その記憶手段12に記憶されているチップ間隔Gとずれ角 θ とを基に、次工程でのピックアップ装置の認識装置、例えばカメラでチップの位置確認を行なうときの位置認識処理や認識した位置にピックアップ用のコレットの位置を合わせる補正処理を行なうことができるようにする。